

АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

- Р. Ромашко, В. Ежов.** ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ MOLEX ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ БУДУЩЕГО № 7, с. 66
- ETHERNET – КЛЮЧЕВОЙ КОМПОНЕНТ СОВРЕМЕННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ № 8, с. 96

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

- Ю. Ковалевский.** ПОДГОТОВКА К ВЗЛЕТУ. ПАНЕЛЬНЫЕ ДИСКУССИИ ФОРУМА «МИКРОЭЛЕКТРОНИКА 2018» № 1, с. 48
- В. Ежов, Н. Елисеев, Ю. Ковалевский, В. Мейлицев.** ELECTRONICA 2018. ОТПРАВЛЯЕМСЯ В БУДУЩЕЕ. ЧАСТЬ 2 № 2, с. 38
- В. Ежов.** ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПАССИВНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ № 3, с. 44
- В. Ежов, Ю. Ковалевский.** ELECTRONICA 2018: ОТПРАВЛЯЕМСЯ В БУДУЩЕЕ. ЧАСТЬ 3 № 3, с. 50
- В. Ежов, Н. Елисеев, В. Мейлицев.** ELECTRONICA 2018: ОТПРАВЛЯЕМСЯ В БУДУЩЕЕ. ЧАСТЬ 4 № 4, с. 28
- Ю. Ковалевский.** II НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ, ЭКБ И МАТЕРИАЛОВ В ЭА ВВСТ № 5, с. 50
- Ю. Ковалевский.** КАК УПРОСТИТЬ ПРОЦЕДУРЫ СОГЛАСОВАНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ И ПРИМЕНЕНИИ ЭКБ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ. III НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФГУП «МНИИРИП» «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ – ЕДИНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОКНО» № 6, с. 52
- Ю. Ковалевский.** АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭМС. VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ» № 6, с. 56
- В. Ежов.** КАК СОЗДАТЬ ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ № 6, с. 58
- Ю. Ковалевский.** СВК КАК ОСНОВА УСКОРЕНИЯ РАЗРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА ГРАЖДАНСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ. СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ № 9 МРГ ПРИ КОЛЛЕГИИ ВПК РФ И КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА РАЗРАБОТЧИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭА И ЭКБ АО «КОНЦЕРН ВКО «АЛМАЗ-АНТЕЙ» № 7, с. 34
- Ю. Ковалевский.** ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЭКБ: СЛОЖНОСТИ НАСТОЯЩЕГО И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БУДУЩЕГО. VIII ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗОЙ. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПОСТАВОК В РАМКАХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ» № 8, с. 32
- Ю. Ковалевский.** КОНФЕРЕНЦИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» № 9, с. 36
- В. Мейлицев.** ТЕХНОЛОГИИ МИКРОЭЛЕКТРОННОЙ СБОРКИ И КОРПУСИРОВАНИЯ. III ЕЖЕГОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ГК «ГЛОБАЛ ИНЖИНИРИНГ» «ТЕХНОЛОГИИ МИКРОЭЛЕКТРОННОЙ СБОРКИ И КОРПУСИРОВАНИЯ» № 9, с. 42

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

- Д. Кострин, В. Симон, Н. Потрахов, А. Ухов.** КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАНИПУЛЯТОР ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ № 10, с. 96

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

- Кс. Биньяле.** ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ КОММУНИКАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВСТРАИВАЕМЫХ СИСТЕМ С ОБЛАЧНЫМИ СЕРВИСАМИ № 2, с. 92
- Ю. Асангханва, Р. Ий, А. Сыров.** ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАНИЧНЫХ УЗЛОВ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ С ПОМОЩЬЮ МИКРОСХЕМ АТЕСС608А КОМПАНИИ MICROCHIP № 7, с. 60

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

- М. Макушин, А. Фомина.** АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 5G-СЕТЕЙ № 6, с. 100
- А. Бороздин.** СИСТЕМА СВЯЗИ КВ- И МВ-ДИАПАЗОНА НА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЕ № 6, с. 114
- И. Коптелов, С. Назаров, М. Ермолова.** ГИПЕРКОНВЕРГЕНТНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ С ВИРТУАЛИЗАЦИЕЙ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА ВИРТУАЛИЗАЦИИ «ГОРИЗОНТ-ВС» № 8, с. 76

КОЛОНКА ДЕПАРТАМЕНТА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

- № 4, с. 16; № 5, с. 21
- В. Шпак.** РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ – НЕ ПРИХОТЬ, А ОСТРАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ № 6, с. 22
- С. Попов.** РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГРАЖДАНСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ СТАНУТ ОСНОВНЫМИ ИГРОКАМИ РЫНКА. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА № 7, с. 22
- № 8, с. 18; № 9, с. 18; № 10, с. 19

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

- Дж. Инь.** В ОБЛАСТИ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ ЕСТЬ СВОЙ «ЗАКОН МУРА» № 1, с. 12
- Э. Халтен.** КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ С МОМЕНТА «РОЖДЕНИЯ» ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ № 1, с. 18
- С. Довгучиц.** ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ОПК № 2, с. 12
- П. Куцько.** МНИИРИП ДОЛЖЕН СТАТЬ ОТРАСЛЕВЫМ ЦЕНТРОМ КОМПЕТЕНЦИЙ № 2, с. 18
- Д. Лобзов.** ВОЗМОЖНОСТИ САПР ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ ОПРЕДЕЛЯЮТ КАЧЕСТВО ВСЕГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СОВРЕМЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ № 3, с. 12
- Т. Катлер.** КАК ПРЕОДОЛЕТЬ РАЗРЫВ МЕЖДУ МОДЕЛИРОВАНИЕМ И ТЕСТИРОВАНИЕМ № 3, с. 20
- Р. Мангушева.** ВЫСТАВКИ КАК ЗЕРКАЛО РЫНКА И ЦЕНТР КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО СООБЩЕСТВА № 3, с. 24

С. Данасекаран. ЧТОБЫ БЫСТРЕЕ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД, КОМПАНИЯМ НУЖНЫ НЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, А ЗАКОНЧЕННЫЕ РЕШЕНИЯ № 4, с. 10

Р. Вага. МИКРОМИНИАТЮРИЗАЦИЯ ДЕЛАЕТ РЕНТГЕН ПОДЧАС НЕЗАМЕНИМЫМ ИНСТРУМЕНТОМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА № 5, с. 12

В. Кожин. ЦИФРОВАЯ ЭРА ТРЕБУЕТ НОВОГО ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ № 6, с. 12

В. Беспалов. ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ БУДУЩЕГО ВУЗУ НЕОБХОДИМА РАЗВИТАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА № 7, с. 10

Е. Иванова. SYNOPSIS: ТРЕНДЫ, РЕШЕНИЯ, МИФЫ № 7, с. 16

Е. Липкин. «ИНДУСТРИЯ 4.0»: ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДОЛЖНА НАЧИНАТЬСЯ В ЦЕХАХ, А НЕ В КАБИНЕТАХ НАЧАЛЬНИКОВ № 8, с. 12

А. Кищинский. МЫ ВИДИМ, ЧТО МОЖЕМ РАЗГОВАРИВАТЬ С ЗАРУБЕЖНЫМИ КОМПАНИЯМИ НА РАВНЫХ № 9, с. 10

А. Роман. СИНЕРГИЯ ПОСТАВОК И ИСПЫТАНИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ КАЧЕСТВЕННОЙ ЭКБ № 10, с. 12

КОНСТРУКТОРСКИЕ РЕШЕНИЯ

С. Фролова, Ф. Путря. СОЗДАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И МУЛЬТИПРОЕКТНОЙ ПЛАТФОРМЫ ПРОТОТИПИРОВАНИЯ НА БАЗЕ КОМПЛЕКТА NAPS КОМПАНИИ SYNOPSIS. ЧАСТЬ 1 № 4, с. 76

С. Фролова, Ф. Путря. СОЗДАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И МУЛЬТИПРОЕКТНОЙ ПЛАТФОРМЫ ПРОТОТИПИРОВАНИЯ НА БАЗЕ КОМПЛЕКТА NAPS КОМПАНИИ SYNOPSIS. ЧАСТЬ 2 № 5, с. 120

Н. Нагаев. КОРПУСА ДЛЯ МИКРОСБОРОК КОМПАНИИ АО «ЗПП» № 6, с. 136

А. Щербина, Л. Федорович. ИЗДЕЛИЯ ИЗ КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ, НИТРИДА АЛЮМИНИЯ И ОКСИДА БЕРИЛЛИЯ ОТ АО «ТЕСТПРИБОР» № 7, с. 106

О. Баринава. КАК ПРАВИЛЬНО ПОДГОТОВИТЬ ПРОЕКТ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ К ПРОИЗВОДСТВУ № 8, с. 118

КОНТРОЛЬ И ИЗМЕРЕНИЯ

Ш. Кацав. КОМПАНИЯ TAVOR ELECTRONICS – ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ СИГНАЛАМИ № 1, с. 118

А. Кривов, Е. Смирнова, К. Бондин, П. Николаев. НЕОБХОДИМОСТЬ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СЛИЧЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ МЕТРОЛОГИИ № 2, с. 58

Б. Дерат, К. Роуэлл, А. Танкелюн, С. Шмитц. ПРОГРАММНЫЕ И АППАРАТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ БЛИЗНЕГО ПОЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ИЗМЕРЕНИЯМ В СВОБОДНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СИСТЕМ СВЯЗИ 5G № 2, с. 66

А. Шостак, Д. Кондрашов, Э. Сутау, М. Крейтлоу. БЫВАЮТ ЛИ ОСЦИЛЛОГРАФЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ? № 2, с. 72

А. Крылов. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КООКСИАЛЬНО-ВОЛНОВОДНЫХ УЗЛОВ С ПОПЕРЕЧНЫМ СЕЧЕНИЕМ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ № 2, с. 76

В. Быканов, Б. Подъяпольский, В. Булгаков. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗРАБОТКИ ЭКБ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ № 3, с. 112

В. Гречишников, А. Курицкий, А. Бутько, А. Иванов. ПЕРИФЕРИЙНОЕ СКАНИРОВАНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ И НЕ ТОЛЬКО: УТАГ-ЛАБОРАТОРИЯ В САМАРСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ № 3, с. 120

Ю. Иванов, А. Никонов, Э. Князева. ИЗМЕРЕНИЕ С-ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КВАРЦЕВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ № 3, с. 124

В. Быканов. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ В ОБЛАСТИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ № 4, с. 102

С. Ведерников. МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ КАК ОДИН ИЗ ЭТАПОВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА № 4, с. 108

Д. Кондрашов, А. Шостак, П. Дейкстра. ИСПЫТАНИЯ НА ВОСПРИИМЧИВОСТЬ К ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМУ ПОЛЮ – НОВЫЕ РЕШЕНИЯ № 4, с. 112

Б. Лапшинов, Н. Тимченко. МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС НА БАЗЕ МАЛОГАБАРИТНЫХ СПЕКТРОМЕТРОВ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ № 5, с. 90

А. Смирнов. ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ ПЛОСКОГО ПОЛЯ ТИПА STEM-КАМЕР ДЛЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ № 6, с. 80

Ю. Синельников. УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ АЧХ СВЧ-ФОТОДИОДОВ № 6, с. 84

М. Соковишин, С. Литвиненко. ПРОБЛЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ V2X И ИХ РЕШЕНИЯ № 6, с. 92

М. Писковацков. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММИРУЕМОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ITESH IT6000S ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ДВИЖИТЕЛЯ С ЭФФЕКТОМ ХОЛЛА № 8, с. 74

Н. Лемешко, П. Струнин. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ДАТЧИКОВ ХОЛЛА ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ИХ МОДЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ КОМПАНИИ RONDE&SCHWARZ № 9, с. 104

Я. Россоский. ОСЦИЛЛОГРАФЫ АКИП-4133 И АКИП-4133/1 С ПОЛОСОЙ ПРОПУСКАНИЯ 16 ГГц. ЧАСТЬ 1 № 10, с. 102

МИКРО- И НАНОСТРУКТУРЫ

А. Сафонов. МАТРИЧНЫЕ КМОП-ФОТОПРИЕМНИКИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ № 2, с. 140

МИКРОМОДУЛИ И МИКРОБЛОКИ

М. Шкопкин, Ю. Мякочин, С. Девликанова. МИНИАТЮРИЗАЦИЯ АППАРАТУРЫ ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МИКРОСБОРОК НА ОСНОВЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МИКРОСХЕМ № 2, с. 136

П. Верник. ПУТЬ К СОКРАЩЕНИЮ СРОКОВ РАЗРАБОТКИ И ЗАПУСКА В ПРОИЗВОДСТВО ПЕРЕДОВОЙ ЭКБ: СВК НА ОСНОВЕ LTCC № 3, с. 170

А. Хохлун, С. Чигиринский. КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «ФЛИП-ЧИП» ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМАХ В КОРПУСЕ № 3, с. 174

В. Мейлицев. 4,5 МЕСЯЦА ОТ ИДЕИ МИКРОМОДУЛЯ ДО ГОТОВОГО ОБРАЗЦА	№ 5, с. 114
А. Щербина. РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МИКРОСБОРОК НА МНОГОСЛОЙНОЙ КЕРАМИКЕ	№ 9, с. 90
В. Жалнин, А. Трифонов, Т. Цивинская. ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ КОРПУСИРОВАНИЯ РАДИАЦИОННО-СТОЙКОЙ МЕМРИСТОРНОЙ ПАМЯТИ	№ 10, с. 124

МИКРОПРОЦЕССОРЫ И ПЛИС

А. Петров, Д. Потехин, И. Тарасов. ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ НА КРИСТАЛЛЕ НА БАЗЕ ПЛИС В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ	№ 1, с. 112
П. Ван. ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ – ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ ДЛЯ IOT	№ 4, с. 42
В. Ежов. СИСТЕМА НА КРИСТАЛЛЕ SmartFusion2 ОТ MICROSEMI: ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ	№ 4, с. 46
А. Строгонов. ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ПЛИС	№ 4, с. 52
И. Тарасов. ПРИМЕНЕНИЕ ПЛИС КЛАССА «СИСТЕМА НА КРИСТАЛЛЕ» XILINX ZYNQ И ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ НА ОСНОВЕ ЯЗЫКОВ ОПИСАНИЯ АППАРАТУРЫ ВЫСОКОГО УРОВНЯ	№ 4, с. 62
Л. Ди Джасио. КАК С ПОМОЩЬЮ НЕЗАВИСИМОЙ ОТ ЯДРА ПЕРИФЕРИИ МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ PIC СИНТЕЗИРОВАТЬ НОВУЮ ФУНКЦИЮ	№ 4, с. 68
А. Строгонов, С. Цыбин, П. Городков. МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ СТОЙКОСТИ ПЛИС СО СТАТИЧЕСКИМ ОЗУ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ	№ 5, с. 98

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ. ДИСКУССИОННЫЙ БАТТЛ О ПУТЯХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ В РАМКАХ ВЫСТАВОК ExpoElectronica И ElectronTechExpo 2019	№ 6, с. 42
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ДИСКРЕТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА: НАСКОЛЬКО ВЕРНЫ СТЕРЕОТИПЫ	№ 10, с. 34

НАДЕЖНОСТЬ И ИСПЫТАНИЯ

М. Макушин, В. Мартынов. НАДЕЖНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ИС: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ	№ 1, с. 146
М. Макушин, В. Мартынов. ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И ВЫХОДА ГОДНЫХ: ТРАДИЦИОННЫЕ И НОВЫЕ ПОДХОДЫ	№ 5, с. 56
С. Аваков, В. Матюшков, А. Вискушенко, А. Казаков. ОТРАСЛЕВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ИСПЫТАНИЙ И НАНОДИАГНОСТИКИ СПЕЦТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ОЛИН СТО)	№ 5, с. 68
С. Доцник, А. Ефремова. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ НА СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ПЛЕСНЕВЫХ ГРИБОВ	№ 5, с. 74

А. Петровичев. ИСПЫТАНИЯ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ HIRF-ПОЛЕЙ	№ 5, с. 80
Д. Кондрашов, А. Шостаков. СИСТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ЭМС МИКРОСХЕМ И ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ	№ 5, с. 84
П. Гребенщиков. ВЫЯВЛЕНИЕ КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ В ОБЛАСТИ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ	№ 6, с. 172
Р. Порядин. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ МИГРАЦИЯ. БОРЬБА С НЕВИДИМЫМ ВРАГОМ	№ 7, с. 144
А. Грибин. КОНТАКТНЫЕ УСТРОЙСТВА АО «ЗПП» ДЛЯ ЭКБ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА	№ 7, с. 152
А. Гербин. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСКОРЕННЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ИЗДЕЛИЙ ЭКБ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА – ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ИХ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ	№ 9, с. 136
Е. Фёдоров. ЭКРАНИРОВАННЫЕ И БЕЗЭЖОВЫЕ КАМЕРЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ НА ЭМС	№ 9, с. 142

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Е. Луковка. ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	№ 5, с. 152
--	-------------

ПОРТРЕТ ФИРМЫ

Э. Чу. КОМПАНИЯ DELSON TECHNOLOGY: ШИРОКИЙ ВЫБОР ПАМЯТИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ	№ 1, с. 70
Б. Беленький. НИИ «ГИРИКОНД» – ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ... (К 80-ЛЕТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ)	№ 3, с. 86
А. Насонов. НАДО ВЕРИТЬ В СЕБЯ И МНОГО РАБОТАТЬ, И ТОГДА ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ	№ 10, с. 40

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

П. Григорьев, Т. Шимчук, Т. Цивинская. АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ПРЯМОЙ МЕТАЛЛИЗАЦИИ ОТВЕРСТИЙ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ. ЧАСТЬ 2	№ 1, с. 128
А. Генцелев. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА НА ПРОИЗВОДСТВЕ	№ 1, с. 138
П. Григорьев, С. Милешин, Т. Цивинская. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАЩИТЫ КОМПАУНДОМ СИЭЛ НА СТАБИЛЬНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МЭМС-СЕНСОРОВ	№ 4, с. 132
С. Никитин, К. Поздняков, О. Хомутская. ОЦЕНКА ДЕФОРМАЦИИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ	№ 5, с. 144
В. Иванов. ХЛОРИРОВАНИЕ В СОЛЕВОМ РАСПЛАВЕ В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ	№ 6, с. 154
Д. Суханов, В. Команов. ГЕТЕРОГЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ГРУППОВОЙ СВАРКИ КРИСТАЛЛ-ПЛАСТИНА – ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОДХОД К 3D-ИНТЕГРАЦИИ МИКРОСХЕМ	№ 6, с. 162

С. Ванцов. СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ОТВЕРСТИЙ В ПЕЧАТНЫХ ПЛАТАХ	№ 6, с. 168
Д. Максимов. ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ХИМИЧЕСКОГО НИКЕЛЯ НА ВАКУУМНУЮ ПЛОТНОСТЬ ПЯЯНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	№ 7, с. 110
О. Боброва, Д. Мануков. 3D-ПЕЧАТЬ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ	№ 7, с. 114
И. Григорьев, Т. Михайлова, Т. Мясоедова. РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОДОВ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ НА ОСНОВЕ КРЕМНИЙ-УГЛЕРОДНЫХ СТРУКТУР	№ 9, с. 96

РЕПОРТАЖ С ПРЕДПРИЯТИЯ

О. Ковалевский, В. Мейлицев. КОРПУСА ДЛЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ. ВИЗИТ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ КОМПАНИИ «ТЕСТПРИБОР»	№ 1, с. 58
О. Ковалевский, В. Мейлицев. ПОЛНЫЙ ЦИКЛ, МИРОВОЙ УРОВЕНЬ. ВИЗИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ «ДИАКОНТ»	№ 3, с. 74
В. Мейлицев. В ПЕРСПЕКТИВЕ МЫ ВИДИМ СЕБЯ В РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ЦЕНТРА ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ. ВИЗИТ НА АЗОВСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД	№ 6, с. 62
В. Мейлицев. КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОНИКИ. ПРОСТЫЕ РЕЦЕПТЫ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ. ВИЗИТ В ООО «МИКРОЭМ ТЕХНОЛОГИИ»	№ 7, с. 40
В. Мейлицев. ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ КРАТНОГО СОКРАЩЕНИЯ СРОКОВ СОЗДАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКБ: СИСТЕМА КОРПУСА НА ОСНОВЕ LTCC. ВИЗИТ В НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «СпецЭлектронСистемы»	№ 8, с. 34
О. Ковалевский, О. Саликова. ПОРА ПЕРЕХОДИТЬ НА РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. ОСОБЕННО, КОГДА ОНИ ЕСТЬ. ВИЗИТ В ООО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР «ЭЛМА»	№ 9, с. 44
О. Ковалевский. ГИБКОСТЬ ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОНТРАКТНОГО ПРОИЗВОДСТВА: ДИЛЕММА РАЗРЕШИМА? ВИЗИТ НА СБОРОЧНО-МОНТАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО КОМПАНИИ ООО «НАНОТЕХ»	№ 9, с. 54

СВЧ-ЭЛЕКТРОНИКА

В. Репин, И. Мухин, М. Дроздецкий, Г. Алексеев. ШИРОКОПОЛОСНЫЙ СВЧ-АТТЕНУАТОР, ВЫПОЛНЕННЫЙ ПО МОСТОВОЙ СТРУКТУРЕ	№ 2, с. 116
В. Кочемасов, Т. Косичкина. УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ ПО СХЕМЕ ДОГЕРТИ. ЧАСТЬ 1	№ 3, с. 144
К. Джуринский, С. Павлов, О. Морозов. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РАДИОЧАСТОТНЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ КМ-ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН	№ 3, с. 154
В. Кочемасов, Т. Косичкина. УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ ПО СХЕМЕ ДОГЕРТИ. ЧАСТЬ 2	№ 4, с. 118
А. Корнев. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОАКСИАЛЬНО-МИКРОПОЛОСКОВЫХ ПЕРЕХОДОВ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА ТИПА SMD	№ 5, с. 106

Г. Алексеев, А. Калёнов, И. Мухин, В. Репин. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДИСКРЕТИЗАЦИЕЙ И КВАНТОВАНИЕМ ДЛЯ СВЧ АЦП	№ 6, с. 72
А. Бугаёв, Ю. Ковалевский. РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ MINI-CIRCUITS: ОТ ВЫБОРА СВЧ-КОМПОНЕНТА ДО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ	№ 6, с. 76
А. Аредов. МИКРОСХЕМА ШИРОКОПОЛОСНОГО СИНТЕЗАТОРА ЧАСТОТЫ ДО 6 ГГц СО ВСТРОЕННЫМ ГУН	№ 7, с. 92
К. Гомес-Дуарте, А. Лезинов. ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗАКАЗНЫХ SMT-КОРПУСОВ ДЛЯ ИС МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА ДЛИН ВОЛН	№ 7, с. 98
В. Кочемасов, С. Дингес, В. Шадский. ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ СВЧ-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СРЕДНЕЙ И БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ. ЧАСТЬ 1	№ 8, с. 108
К. Джуринский, В. Батаев. СОЕДИНИТЕЛИ 1.35 mm ДЛЯ РАБОТЫ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 0–90 ГГц	№ 8, с. 114
В. Кочемасов, С. Дингес, В. Шадский. ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ СВЧ-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СРЕДНЕЙ И БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ. ЧАСТЬ 2	№ 9, с. 116
К. Джуринский. ЭВОЛЮЦИЯ РАДИОЧАСТОТНЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ ДЛЯ МОБИЛЬНОЙ И СОТОВОЙ СВЯЗИ	№ 10, с. 74
В. Кочемасов, С. Дингес, В. Шадский. ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ СВЧ-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СРЕДНЕЙ И БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ. ЧАСТЬ 3	№ 10, с. 82

СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

О. Пчельникова-Гротова. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ АВТОНОМНЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК	№ 1, с. 120
О. Пчельникова-Гротова, А. Иванов, В. Латыпов. УСТРОЙСТВО СЛЕЖЕНИЯ ЗА СОЛНЦЕМ В ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ	№ 2, с. 120
Е. Рабинович. ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ TDK-Lambda СЕРИИ GXE. УПРАВЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ В ПРОМЫШЛЕННОМ КОНСТРУКТИВЕ	№ 2, с. 128
Ф. Досталь. СНИЖЕНИЕ ПОМЕХ В СИНХРОННЫХ Понижающих ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ С ПОМОЩЬЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИОДА ШОТТКИ НА ПРИМЕРЕ ADP2443 ОТ КОМПАНИИ ANALOG DEVICES	№ 5, с. 112
Т. Брэнд. КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОЛИРОВАННЫХ ДРАЙВЕРОВ ЗАТВОРА МОЩНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ	№ 7, с. 88
М. Савин, С. Абрамов. РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЛАНАРНОГО ТРАНСФОРМАТОРА ДЛЯ ОБРАТНОХОДОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ	№ 8, с. 40
Ф. Досталь. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОДНОВРЕМЕННОГО ОТКРЫТИЯ КЛЮЧЕЙ В СИНХРОННЫХ Понижающих ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ ПРИ ЗАМЕДЛЕНИИ ФРОНТОВ ИМПУЛЬСОВ	№ 8, с. 46
М. Макушин. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ	№ 8, с. 50

Х. Куек, А. Буквин. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ НА ГЕНЕРИРУЕМЫЕ ПОМЕХИ ИМПУЛЬСНЫХ ИВП НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИОННОГО ПОДХОДА И ТЕХНОЛОГИИ SILENT SWITCHER	№ 8, с. 58
У. Ву. КАК ВЫБРАТЬ ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПУСКОВЫХ ТОКОВ И ПЕРЕРЫВАТЕЛЬ ЦЕПИ ДЛЯ ИМПУЛЬСНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ	№ 8, с. 62
В. Ежов. РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ MORNSUN ДЛЯ СИСТЕМ ПИТАНИЯ В УМНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ	№ 8, с. 68

СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

С. Кокин, В. Перминов, С. Волков, С. Морозов. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ТЗЧ В САПР «КИПАРИО»	№ 3, с. 92
Ж.-Ф. Бинуа, С. Белоусов, Ю. Ковалевский. СРЕДСТВА СТАТИЧЕСКОЙ ВЕРИФИКАЦИИ SpyGlass и VC LP ПОИСК ОШИБОК НА УРОВНЕ RTL	№ 3, с. 98
В. Ежов. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТРЕБУЮТ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ. ПО МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ, ОРГАНИЗОВАННОЙ КОМПАНИЕЙ «ПСБ СОФТ»	№ 3, с. 104
С. Белоусов. ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ТЗЧ УСТРОЙСТВ НА БАЗЕ ПЛИС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТА SYNPLIFY PREMIER	№ 4, с. 82
М. Макушин, А. Фомина. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАК ДВИЖУЩИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ САПР	№ 4, с. 90
Д. Лобзов, А. Лохов. РЕШЕНИЯ MENTOR, А SIEMENS BUSINESS ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИС И ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ. ЧАСТЬ 1	№ 5, с. 126
А. Глинкин, К. Никеев, Б. Филипов. РЕШЕНИЯ MENTOR, А SIEMENS BUSINESS ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИС И ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ. ЧАСТЬ 2	№ 6, с. 140
А. Петровичев. АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ	№ 8, с. 122
Ю. Леган. РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ В ИЕРАРХИЧЕСКОЙ ФОРМЕ. ЧАСТЬ 1	№ 10, с. 130

СОБЫТИЕ НОМЕРА

В. Ежов, Н. Елисеев, Ю. Ковалевский. ELECTRONICA 2018: ОТПРАВЛЯЕМСЯ В БУДУЩЕЕ. ЧАСТЬ 1	№ 1, с. 34
О. Казанцева. РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	№ 5, с. 22
Ю. Ковалевский. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЕСПИЛОТНОГО ТРАНСПОРТА. СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ ОПК И РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВОЕННОЙ АВИАЦИИ И АВИАСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА КОМИТЕТА СФ ПО ОБОРОНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ	№ 6, с. 18

СХЕМОТЕХНИКА

С. Пескова. УБИТЬ USB-КИЛЛЕРА	№ 2, с. 102
А. Воронин. СТРУКТУРА КАНАЛОВ ДЛЯ СЧИТЫВАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОНИКИ КРЕМНИЕВЫХ ДЕТЕКТОРОВ	№ 2, с. 106
А. Воронин. ШУМОВЫЕ СВОЙСТВА И ПАРАМЕТРЫ СИГНАЛОВ В ГОЛОВНОЙ ЧАСТИ КАНАЛА СЧИТЫВАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРОНИКИ ДЛЯ КРЕМНИЕВЫХ ДЕТЕКТОРОВ	№ 10, с. 114

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

А. Калмыков, В. Мейлицев. КАЧЕСТВО ЧЕРЕЗ АВТОМАТИЗАЦИЮ: ТРАФАРЕТНЫЙ АВТОМАТ G-TITAN КОМПАНИИ SKG	№ 3, с. 184
А. Алексеев, С. Петров, Е. Чукавов. ОТ ЗАМЫСЛА ДО ВОПЛОЩЕНИЯ: ПРИНЦИПЫ УСПЕШНОГО ПАРТНЕРСТВА РАЗРАБОТЧИКОВ СТО И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭКБ	№ 3, с. 190
Д. Поцелуев. МЫ ПОСТАВЛЯЕМ НЕ ТОЛЬКО МАТЕРИАЛЫ, НО И ЗНАНИЯ, И ТЕХНОЛОГИИ	№ 5, с. 134
Г. Степанищев. ПРЕЦИЗИОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ ДОЗИРОВАНИЯ ЖИДКИХ ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОТ NORDSON EFD	№ 5, с. 142
С. Шиляев, С. Постнов. ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ И ДИЭЛЕКТРИКОВ АРГОНОВОЙ СВЧ-ПЛАЗМОЙ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ	№ 6, с. 150
Е. Астахов, А. Астахова, П. Царин, И. Колганов, С. Горобец. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМОХИМИЧЕСКИ СТОЙКИХ ФИЛЬТРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ В МИКРОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	№ 7, с. 128
Н. Левкина, А. Медведев. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ВЛАГОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ	№ 7, с. 134
Ш. Сарновски. «ЛИСА», «ПУМА», «ТАРАНТУЛ»: ГИБКОСТЬ И АДАПТИВНОСТЬ ПОЧТИ КАК В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ	№ 8, с. 126
Е. Астахов, А. Астахова, П. Царин, И. Колганов, С. Горобец, А. Дымова. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НУЖД РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	№ 8, с. 130
А. Завалко. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СБОРОЧНЫЕ ЦЕНТРЫ: КАК УСКОРИТЬ ВЫВОД НА РЫНОК СЛОЖНЫХ И УНИКАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	№ 9, с. 66
М. Макушин, В. Мартынов. ОСВОЕНИЕ EUV-ЛИТОГРАФИИ В СЕРИЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ	№ 9, с. 70
С. Аваков, В. Плебанович, А. Лапко. ГЕНЕРАТОРЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ БЕЗМАСКОВОЙ ЛИТОГРАФИИ	№ 9, с. 80
Д. Поцелуев. ВЛАГОЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ: ЧТО НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ ПРИ ВЫБОРЕ	№ 9, с. 86

ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

А. Генцелев. СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЕФЕКТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ	№ 3, с. 180
---	-------------

Р. Ромашко, В. Ежов. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМПАНИИ HARTING ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА: КОГДА ЗАКАЗЧИК СТАНОВИТСЯ ПАРТНЕРОМ	№ 9, с. 132
Д. Чернов. ИСТОРИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ОДНОГО ПРОЦЕССА, ИЛИ КАК ОЦИФРОВАТЬ РУЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО	№ 10, с. 136

ЭКОНОМИКА + БИЗНЕС

Н. Кульчицкий, А. Наумов, В. Старцев. РЫНОК НЕОХЛАЖДАЕМЫХ МИКРОБОЛОМЕТРОВ ДЛЯ ИК-КАМЕР: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ	№ 1, с. 156
М. Макушин, А. Фомина. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ КНР	№ 2, с. 158
А. Фомина. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	№ 4, с. 140
Ю. Ковалевский, Е. Суворов. РЫНОК И ТЕХНОЛОГИИ В СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ: ОТЧЕТЫ Yole Développement	№ 5, с. 156
В. Разумов. ВНЕШНЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ОТ ФОНДА: ТАК ЛИ ЭТО СЛОЖНО, КАК КАЖЕТСЯ?	№ 6, с. 176
Н. Тюрнев. ВНЕШНЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ	№ 7, с. 158
М. Макушин, А. Фомина. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ КНР И ТАЙВАНЯ	№ 7, с. 160
Г. Левин. ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МФППП. РЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ	№ 8, с. 136
А. Фомина. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ	№ 8, с. 140

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

М. Самойлова. ЩЕЛК, И ГОТОВО! МОДУЛЬНЫЕ РАЗЪЕМЫ ODU-MAC® BLUE-LINE	№ 10, с. 62
Р. Ромашко, В. Ежов. ВЫСОКИЕ СКОРОСТИ ТРЕБУЮТ УМНЫХ РЕШЕНИЙ: КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛИ MOLEX ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В ДАТА-ЦЕНТРАХ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ	№ 10, с. 68

ЭЛЕКТРОННАЯ КОМПОНЕНТНАЯ БАЗА

М. Макушин, И. Черепанов. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДАННЫХ	№ 1, с. 74
В. Осипов. ПРИМЕНЕНИЕ СЧК 1879ВВЯ1 В КАЧЕСТВЕ МНОГОКАНАЛЬНОГО АМПЛИТУДНОГО АНАЛИЗАТОРА ЦИФРОВОГО СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО ТРАКТА	№ 1, с. 82
Г. Алексеев, В. Репин, И. Мухин, М. Дроздецкий. ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ 8-РАЗРЯДНЫЙ БИКМОП АЦП	№ 1, с. 88
В. Ежов. АЦП И ЦАП ANALOG DEVICES: ОБЗОР НОВИНОК 2018 ГОДА	№ 1, с. 92
В. Ежов. МЭМС-ДАТЧИКИ MURATA: ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ	№ 1, с. 104
Дж. Стивенсон, О. М. Азиз. PULSE ELECTRONICS: ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ПРИМЕНЕНИЙ	№ 2, с. 96

П. Пастухов. СИНХРОННОЕ СТАТИЧЕСКОЕ ОЗУ КОНВЕЙЕРНОГО ТИПА	№ 3, с. 130
В. Громов, Н. Брюхно, В. Стрекалова, Т. Паньков, С. Алёхин. НОВАЯ СЕРИЯ БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА ЗАО «ГРУППА КРЕМНИЙ ЭЛ»	№ 3, с. 138
О. Конц, А. Фадеева. НОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ И РЕШЕНИЯ ОТ Würth Elektronik: ВСЁ МЕНЬШЕ МЕСТА ДЛЯ «МАГИИ» В ЭЛЕКТРОНИКЕ	№ 5, с. 102
В. Смирнов, А. Харитонов, А. Шалаева, А. Сак. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ БЗЗ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО МОНТАЖА	№ 6, с. 120
В. Кочемасов, С. Хорев. КОНДЕНСАТОРЫ ПЕРЕМЕННОЙ ЕМКОСТИ. ЧАСТЬ 1	№ 6, с. 128
А. Щепанов. РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ: ВЗГЛЯД ЭКСПЕРТА	№ 7, с. 74
В. Кочемасов, С. Хорев. КОНДЕНСАТОРЫ ПЕРЕМЕННОЙ ЕМКОСТИ. ЧАСТЬ 2	№ 7, с. 78
М. Соколов, В. Ежов. ПЛЕНОЧНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ WIMA: ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ С БЕЗУПРЕЧНОЙ РЕПУТАЦИЕЙ	№ 8, с. 102
М. Макушин, И. Черепанов. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОНДЕНСАТОРОВ	№ 10, с. 50
Н. Брюхно, В. Громов, М. Котова, Ю. Севастьянов, В. Стрекалова, В. Пугачев. ДИСКРЕТНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ НА ОСНОВЕ КРЕМНИЯ	№ 10, с. 56

ЭЛЕКТРОНИКА ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

А. Брыкин. УСТРАНЕНИЕ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПРАКТИК ПРИ ЗАКУПКЕ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОДУКЦИИ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ	№ 7, с. 48
И. Корнеев, В. Польщиков, А. Шилов. НОВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ГЛОНАСС / GPS / GALILEO НАВИГАЦИОННЫЙ ПРИЕМНИК ПРО-04	№ 7, с. 52
Т. Гужкова, А. Раскин. НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА НА БАЗЕ ПОЗИСТОРОВ	№ 7, с. 56
Ю. Мякочин, М. Бирюков. МИЛЛИМЕТРОВЫЕ РАДАРЫ АО «ПКК МИЛАНДР» ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА АВТОТРАНСПОРТЕ И В СИСТЕМАХ БЕЗОПАСНОСТИ	№ 8, с. 90

Санкт-Петербург, Россия
ул Матроса Железняка,
д. 57, лит. А, пом. 120-Н
Телефон: 7-812-3259792

Москва, Россия
Лужнецкая набережная, 2/4,
строение 19, офис 119
Телефон: 7-095-7477590

VITAL-IC

Поставки электронных компонентов
широкой номенклатуры
Системы RFID: поставка и консультации

XILINX **Mini-Circuits**
ALTERA